

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳盡說明，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們估計將收取[編纂][編纂]淨額約[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)。根據我們的戰略，我們擬將[編纂][編纂]按下述金額用於下述用途：

	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	[編纂] 淨額概約 總百分比
提升我們的底層技術 能力及工藝平台	21%	15%	26%	19%	21%	18%
進一步豐富我們的 產品組合	11%	15%	19%	24%	31%	22%
擴展我們的海外銷售 網絡及於海外市場 推廣我們的產品	17%	18%	20%	22%	24%	25%
戰略投資及／或收購 營運資金及一般企業 用途	20%	20%	20%	20%	20%	25%
	20%	20%	20%	20%	20%	10%
年度進度總額	17%	17%	21%	21%	23%	100%

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)預計將用於提升我們的底層技術能力及工藝平台。具體是：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)，將用於採購研發設備，以支持我們持續的技術迭代和研發能力建設，包括(a)晶圓及芯片級工藝與故障分析，如X光檢測系統及超聲波顯微鏡；(b)環境及可靠性壓力測試設備，如高溫操作壽命測試系統及熱致洩漏測試儀；(c)電氣性能檢測設備，如自動測試設備及功率測試儀；及(d)表面結構分析設備，如反應離子刻蝕及探針台；
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)，將於未來五年用作吸引及挽留106名研發人才，以及國際頂尖高校人才，從而持續提升我們的研發能力。研發人才的平均年薪預期為每人人民幣50萬元至人民幣1百萬元；
 - (iii) [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)，將用作維護及升級我們研發中心及研發設施；
 - (iv) [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)，將用於研發軟件工具，例如EDA軟件及多次可編程IP，以及開發共享IP平台，以促進我們的芯片設計；及
 - (v) [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)，將用於支持我們的工藝工程及開發工作。特別是，我們計劃產生與工藝確認及良率優化所需的光掩膜、消耗品、輔助材料及工程驗證有關的成本。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)預計將用於進一步豐富我們的產品組合，重點擴大汽車電子應用中的產品。隨著我們擴大產品組合，我們需要更龐大的具備模擬設計及產品可靠性測試的專業知識的高技術工程師團隊。增加研發人員對於加速我們的創新管線、增強定製化能力及支持從設計到量產的芯片開發整個生命週期而言，都是不可或缺的：
- (i) [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)將用於擴展各類模擬芯片，確保覆蓋主要應用領域，從而提升我們的產品組合。具體而言，我們計劃在以下方面投入額外成本：(a)為產品開發採購晶圓和芯片封裝測試服務，以及通過投資關鍵設備來支持我們的封裝測試服務供應商的產能提升；及(b)於未來五年招聘及挽留78名在傳感器產品、信號鏈芯片及電源管理芯片方面具有豐富經驗的產品開發人員，以協助開發符合終端客戶需求的產品。預計研發人才的平均年薪為每人人民幣90萬元至人民幣1百萬元。通過持續的產品創新，我們將持續滿足不斷變化的客戶需求，加強我們的行業影響力；及
- (ii) [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)將用於進一步完善我們的汽車產品矩陣，專注於車身電子、熱管理及智能座艙系統等應用。此外，我們將擴展至智能駕駛、底盤安全及新一代車內經驗。透過擴大我們的產品類別，我們預期單車產品價值將會增加，並將進一步鞏固我們在汽車電子行業的領導地位。我們預期在以下方面產生額外成本：(a)產品認證過程；(b)為產品開發採購晶圓和芯片封裝測試服務，以及通過投資關鍵設備來支持我們的封裝測試服務供應商的產能提升；及(c)於未來五年招聘及挽留114名在汽車市場具有豐富經驗的產品開發人員。預計研發人才的平均年薪為每人人民幣90萬元至人民幣1百萬元。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)預計將用於擴展我們的海外銷售網絡及於海外市場推廣我們的產品。具體而言，我們預期：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)將用於構建全球銷售網絡，以協助擴大我們的銷售覆蓋範圍，並為海外客戶提供及時的銷售服務；我們預期將產生以下成本：(i)未來五年招聘約58名銷售人員，及(ii)根據業務需求及市場優先級，在東南亞、韓國、日本及歐洲(例如德國)租賃海外辦公室；
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)將用於獲取及吸引國際頂級客戶，加深我們與全球行業領導者的關係。我們計劃在(i)與當地經銷商及銷售渠道夥伴合作。產生的成本將計入銷售及營銷開支(ii)海外客戶關係營銷活動，例如(其中包括)推出宣傳活動以及參加展會和論壇以進一步提升我們的品牌知名度方面投入成本；及
 - (iii) [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)將用於加強我們的全球供應鏈及物流系統，以確保產品無縫交付、提高客戶滿意度及降低地供應鏈風險。我們計劃在(i)未來五年招聘約11名供應鏈人員，及(ii)投資海外物流及倉儲基建以提高交付效率方面投入成本。
- [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)預計將用於戰略投資及／或收購，以實現我們的長期增長策略。我們在國內及國際市場尋求潛在投資及收購機會，旨在擴大我們的產品組合、提升我們的市場覆蓋範圍以及加強我們的供應鏈能力。我們評估半導體生態系統基礎設施的投資機會，包括先進的封裝測試及工藝技術，以進一步鞏固我們的競爭優勢。

未來計劃及[編纂]用途

尤其是，我們預期目標公司(i)擁有成熟且相對全面的產品矩陣，主要包括模擬芯片(例如電源管理芯片、驅動、接口、運算放大器、ADC)及傳感器產品(例如流量、編碼器、慣性及光電感測器傳感器)；(ii)專注於高壁壘應用，例如工業、汽車、醫療及家電，並在其各自的市場分部名列前三；(iii)擁有強大的客戶基礎或經銷渠道；(iv)擁有穩定且具實力的研發團隊；(v)採用fabless商業模式；及(vi)保持穩定的盈利能力，或展現明確的協同盈利能力的路徑。我們通過有效整合行業資源，鞏固競爭地位，推動可持續的長期價值創造。除收購外，我們計劃與領先的科技公司、大學及研究機構探索戰略合作夥伴關係，推動協同創新。根據弗若斯特沙利文的資料，估計市場上現有50-100個目標。目前，我們仍在尋找潛在目標，且尚未物色到任何具體目標，或參與任何商業談判或就任何潛在目標簽訂任何諒解備忘錄或意向書。

- [編纂]淨額約[編纂]或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)預計將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂][編纂]淨額多於或少於預期(包括因(i)[編纂]設定高於或低於[編纂]範圍的中位數；或(ii)行使[編纂]的額外[編纂]淨額)，我們將按比例調整[編纂]淨額的分配以用作上述用途。

倘我們發展計劃的任何部分因政府政策變動等原因導致我們任何項目的開發不可行或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃進行，我們將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂][編纂]淨額。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用作上述用途或我們無法按預期實施計劃的任何部分，以及在相關法律及法規准許的情況下，我們僅會將該[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規)的短期計息賬戶。於此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。